# 表面実装ローパスフィルタ・DC–190 MHz

基板設計前に 50 Ω の接続、表面実装用ランド形状、パッケージ寸法 18.8 × 11.18 × 6.86 mm を確認してください。

## RF 特性

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通過帯域 | DC–190 MHz |
| 通過帯域内挿入損失 [1] | ≤1.0 dB |
| 阻止域減衰量 [2] | ≥20 dB |
| 阻止域減衰量 [3] | ≥40 dB |
| VSWR [1] | 1.4:1 (代表値) |
| −3 dB 周波数 | 210 MHz |

[1] DC–190 MHz
[2] 290–390 MHz
[3] 390–1000 MHz

## 設計定格 設計保証

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 許容電力 | 0.5 W |
| 動作温度 | −40…+85 °C |
| 保存温度 | −55…+100 °C |

## 代表実測応答

| 周波数 (MHz) | S11 VSWR | S22 VSWR | S12 損失（dB） |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.03 | 1.28 | 0.02 |
| 21 | 1.16 | 1.15 | -0.35 |
| 43 | 1.34 | 1.35 | -0.27 |
| 64 | 1.36 | 1.36 | -0.47 |
| 86 | 1.23 | 1.23 | -0.7 |
| 107 | 1.08 | 1.09 | -0.51 |
| 129 | 1.13 | 1.11 | -0.57 |
| 150 | 1.19 | 1.16 | -0.63 |
| 171 | 1.15 | 1.11 | -0.87 |
| 193 | 1.18 | 1.26 | -0.8 |

## 代表実測応答

| 周波数 (MHz) | S11 VSWR | S22 VSWR | S12 損失（dB） |
|---|---|---|---|
| 214 | 1.32 | 1.51 | -1.49 |
| 236 | 4.6 | 4.91 | -6.13 |
| 257 | 234.75 | 53.91 | -13.1 |
| 279 | 9.46 | 11.56 | -23.45 |
| 300 | 12.18 | 10.04 | -30.89 |

## 機械仕様

| 項目 | 値 |
|---|---|
| パッケージ寸法 | 18.8 ±0.2 × 11.18 ±0.2 × 6.86 ±0.2 mm |
| RF インピーダンス | 50 Ω |
| 実装方式 | 表面実装 |
| RF 端子 | 1, 8 |
| グラウンド端子 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 品質グレード | 産業用 |
| はんだパッド寸法 | 1.52 × 1.4 mm |
| 同列の隣接パッド中心間ピッチ | 5.08 mm |
| パッド配列の外縁間寸法 | 16.76 × 11.94 mm |

## 基板実装

清掃時は製品の表面を拭き、洗浄液に浸さないでください。 190 °C のリフローはんだ付けに対応します。 PCBランドパターンは4パッドずつの2列です。端子1が左上となる底面視で、上段は1、3、5、7、下段は2、4、6、8です。端子1と8はRF入出力用です。端子2～7はグラウンドに接続します。 底面視で端子1の切り欠き幅は1.52 mm、上端からの奥行きは1.02 mmです。端子2と4の中心間隔は5.08 mmで、端子2の中心は左端から1.78 mmです。端子8のメタライズ部は右端から3.54 mm、下端から2.22 mmの範囲です。

**文書に関する注意**

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。